

2014年5月29日

大きなギャップに対応した電子デバイス用レーザー封止材料を販売開始

日本電気硝子株式会社（本社：滋賀県大津市 社長：有岡雅行）は、ガラスリボンとガラスペーストを組み合わせ、30 μ m（マイクロメートル※）以上のギャップ（隙間）を実現する電子デバイスのレーザー封止技術を開発し、その封止材料（以下、本製品）の販売を開始しました。6月4日から開催される「JPCA Show 2014（第44回国際電子回路産業展）」（於：東京ビッグサイト）に出展いたします。

従来のガラスペーストによる電子デバイスのレーザー封止は、基板間のギャップ厚が最大5 μ m程度で、それ以上のギャップ厚を確保することができませんでした。しかし、本製品はガラスペーストをガラスリボンの両面に塗布した構造を持つため、ガラスペーストのみによる封止と比べ、大きなギャップの封止が可能となります（添付、封止イメージ図ご参照）。

大きなギャップに対応したレーザー封止は、光学素子や太陽電池などでの封止用途が期待されています。当社としては、本製品をガラスリボンの新たな用途として、積極的に販売を展開してまいります。

（※）マイクロメートル： 1,000分の1ミリメートル

<製品寸法>

- ・ ギャップ厚： 30 ～ 60 μ m（左記以外のギャップ厚をご要望の場合はご相談ください）
- ・ ガラスリボン寸法：
 - 幅 - 2.5mm ～ 20.0mm
 - 厚さ - 20 μ m ～ 50 μ m
 - 長さ - ～ 150mm

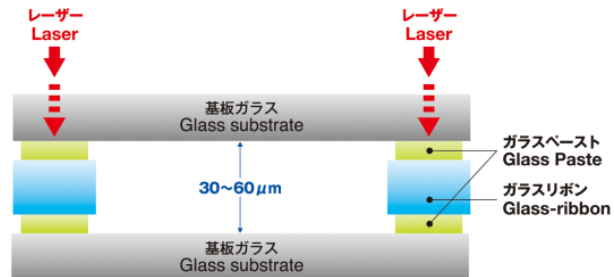
<その他メリット>

- ・ ギャップの平行度の確保
ガラスリボンを使うことにより、ロッドや球状のギャップスペーサーを使う場合と比べ、より精密な平行度を確保できる。
- ・ 作業工程の簡略化
封止する場合、レーザー照射のみを行うだけよい。（従来は、ユーザー自身がガラスペーストの塗布～乾燥～レーザー照射に至る一連の作業を行う必要あり）

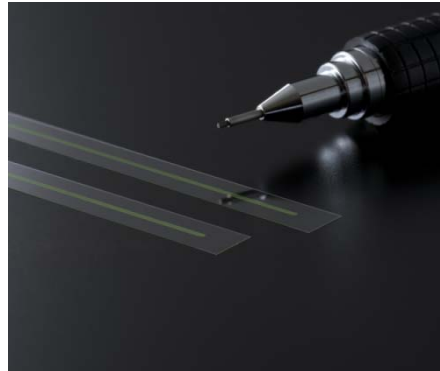
以上

<参考資料>

(封止イメージ)



(製品写真)



(ガラスリボンについて)

ガラスリボンは、当社が開発した極薄のリボン状ガラスで、その薄さは 4μm~50μm、幅は 0.5mm~20mm。ガラス表面は無研磨にもかかわらず、非常に平滑で、両側面の端部が丸みを帯びているため、曲げやねじりに強い。

(リリース内容に関するお問い合わせ先)

日本電気硝子(株) 総務部 広報担当

電話 : 077-537-1861

(製品に関するお問い合わせ先)

日本電気硝子(株) 電子部品事業本部営業部

電話 : 077-537-8767